

RECHERCHE EUROPÉENNE

Packaging et interconnexion: Pidea+ est lancé

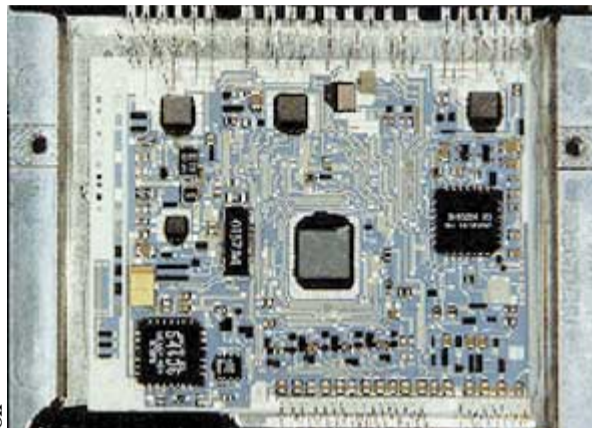
Eureka vient de labelliser le programme Pidea+ dédié aux technologies d'interconnexion et de packaging pour la période 2004-2009. Il est soutenu par six pays, dont la France.

Sophia-Antipolis – L'électronique reste une composante essentielle d'Eureka. Après avoir renouvelé leur confiance au programme stratégique sur la microélectronique et à celui sur les microsystèmes, à travers lesancements respectifs de Medea+ en 2001 et d'Eurimus II en octobre 2003, les représentants de haut niveau d'Eureka viennent de donner leur feu vert au démarrage de Pidea+, centré sur les technologies de packaging et d'interconnexion. Successeur de Pidea qui s'achève cette année avec 35 projets labellisés en 4 ans pour un budget de 305 M€ (contre 400 M€ prévus initialement), Pidea+ s'étendra sur 5 ans avec un budget prévisionnel de 600 M€, part publique incluse. Celle-ci, qui est de l'ordre de 30 % en France, représente un montant annuel de 5 à 10 M€ pour ce programme, précise le

ministère de l'Industrie. Parmi les six pays engagés dans Pidea+, notre pays prévoit d'apporter la contribution publique la plus importante (22%), suivi par l'Allemagne (20%), l'Italie (10%), la Belgique (8%), l'Espagne (7%) et la Finlande (5%). Six autres pays se sont déclarés "intéressés" et devraient soutenir leurs industriels s'ils intervenaient dans ce programme.

Un spectre d'applications élargi à la médecine et à la sécurité

Pidea+ poursuit l'objectif principal de Pidea qui était d'accompagner les améliorations des performances des semi-conducteurs en matière d'interconnexion et de packaging et d'investiguer de nombreuses technologies (notamment RF et optique) qui s'avèrent stratégiques pour l'industrie électronique en Europe. Alors que Pidea était dédié aux technologies de l'information et des télécommunications, aux transports et aux procédés de production, Pidea+ englobe également les applications dans le domaine de la médecine et de la sécurité (par exemple celles liées à la carte à puce). Il cherche à promouvoir des technologies de pointe telles que l'intégration 3D, les *system-in-package*, le *packaging* au niveau du substrat (*wafer level*



Pidea+ poursuit l'objectif principal de Pidea: accompagner les améliorations des performances des semi-conducteurs.

packaging), l'optoélectronique, et à participer ainsi à l'amélioration des performances de produits tels que la carte à puce, les produits nomades, les systèmes d'affichage et les capteurs dans le domaine de la médecine, secteur qui a des besoins particuliers en la matière.

Pidea+ a également pour mission de défendre l'industrie européenne de l'interconnexion et du packaging en termes de production dans un contexte de délocalisation et d'externalisation croissantes. Même si certaines productions de masse ont été

délocalisées en Asie et en Europe de l'Est (où l'on trouve d'ailleurs certains pays membres d'Eureka), Pidea+ a un rôle à jouer dans des domaines où l'Europe a traditionnellement une position forte (transports, télécommunications, électronique professionnelle et industrielle) et, plus généralement, pour les activités nécessitant une main-d'œuvre hautement qualifiée.

«Le premier appel à projets de Pidea+ sera lancé dans le courant du mois de mai pour une labellisation au dernier trimestre

2004», précise Patrick Druenne, président de Pidea+, qui succède dans cette fonction à Yves Le Goff (voir notre rubrique "Décideurs" page 4). Les priorités technologiques du programme sont décrites dans un livre blanc qui sera accessible, début avril, sur le site de Pidea+ : www.pidea.com.fr.

«Le budget 2004 servira à soutenir des projets Pidea en cours d'exécution. Les nouveaux projets labellisés dans le cadre de Pidea+ devraient, quant à eux, n'obtenir un financement qu'à compter de 2005», précise Patrick Druenne.

Jacques Marouani ■

CRISE DE L'ÉLECTRONIQUE FRANÇAISE

La filière électronique est maintenant écoutée par la ministre de l'Industrie

Les syndicats de l'électronique, soutenus par la ministre déléguée à l'Industrie, préparent un "livre bleu" et des Assises qui se tiendront le 5 juillet.

Pour la première fois depuis le cri d'alarme lancé par les syndicats de l'amont de la filière électronique en juillet 2003, la ministre déléguée à l'Industrie, madame Nicole Fontaine, a reçu l'ensemble des syndicats concernés, le 15 mars dernier (voir notre numéro du 18 mars). A l'occasion d'une conférence de presse, trois jours plus tard, ces syndicats –auxquels s'est joint le syndicat Alliance-TICS (informatique et télécoms)– ont exprimé à la fois leur satisfaction de se voir désormais écoutés et compris, et leur volonté de poursuivre l'action engagée pour mettre en œuvre tout ce qui est possible afin que l'électronique française reprenne une croissance forte «tout en maîtrisant le mouvement des délocalisations». Quatre réunions de travail auront lieu en particulier avec le

ministère avant les prochaines Assises de la filière, le 5 juillet prochain.

Points forts de la réunion du 15 mars: la réaffirmation par les syndicats que «l'électronique est stratégique pour l'indépendance politique et la croissance économique du pays» et la présentation des conclusions du rapport du chargé de mission de la ministre concernant cette affaire, Emmanuel Sartorius. Sur le premier point, les syndicats continuent de déplorer la réduction des budgets publics touchant la recherche dans notre secteur, aussi bien sur le long terme (disparition quasi totale en 15 ans de deux tiers des aides, celles en provenance des télécoms et de la DGA) que sur le court terme (budget du ministère de l'Industrie/Digitip réduit de 280 M€ en 2003 à 140 M€ en 2004, dont l'opération Crolles II en semi-conducteurs). Autant d'affaiblissements qui contribuent à la désindustrialisation et à la fragilisation à la fois de nos pôles de compétences en R&D et de nos PME.

Les axes de travail sur le point d'être définis

Le rapport Sartorius propose au ministère de cibler ses actions sur des créneaux à forte technicité, des développements en amont et en aval de la chaîne de valeur (études, intégration, packaging, test, logistique...) et de viser pour les productions en France le prototypage, la tête de série, la petite série, et la proximité avec le donneur d'ordre. Parmi les mesures d'accompagnement, il propose la création d'une structure syndicale forte, la

réduction du nombre des petites entreprises, une aide au "comment produire" et pas seulement "quoi produire", et un assainissement de la TVA. Parmi les mesures générales à prendre, le rapport cite une «sensibilisation des acteurs» de façon à jouer l'équipe France et d'avoir plus «d'acheteurs citoyens», mais il demande aussi de faire en sorte que la France aime plus l'industrie; il réaffirme la nécessité de s'appuyer sur l'axe franco-allemand et de travailler dans un cadre européen.

M^{me} la ministre, en réponse aux syndicats, a affirmé que la filière électronique était une priorité gouvernementale, que la désindustrialisation n'était pas une fatalité et que le budget de la Digitip serait revu en hausse en 2005 «avec obligation de résultats». Elle a également annoncé la création d'un groupe de travail sur la filière et assuré qu'elle interviendrait personnellement lors des Assises du 5 juillet prochain (auxquelles participera également Francis Mer). Les syndicats travaillent à court terme sur un livre bleu dont l'objectif est de réunir des idées pour redonner «une ambition industrielle à notre pays et relancer ainsi la croissance». «Sortons de la crise par le haut», a réaffirmé Pierre Gattaz, vice-président Fieec et porte-parole de la filière électronique, lors de la conférence de presse. Le livre bleu proposera particulièrement de grands programmes sociétaux et stratégiques (Internet très haut débit, TVHD, routes et voitures intelligentes, sécurité, efficacité énergétique...).

J.-P.D.M. ■

EN BREF

SEMICONDUCTEURS: LES ETATS-UNIS PORTENT PLAINTES CONTRE LA CHINE DEVANT L'OMC

Les Etats-Unis viennent de porter plainte contre la Chine devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), lui reprochant de favoriser les fabricants de semi-conducteurs locaux au détriment des étrangers. Les semi-conducteurs produits en Chine sont en effet taxés à hauteur de 3% alors que les semi-conducteurs provenant de l'étranger supportent une TVA de 17% (voir notre numéro du 6 novembre 2003). L'an passé, les exportations américaines de semi-conducteurs vers la Chine ont atteint 2,02 milliards de dollars et l'imposition d'une TVA de 17% a coûté environ 344 millions de dollars aux fabricants américains. «Ce cas est un cas clair et net de violation des principes de l'OMC», a estimé Leslie Griffin, directrice pour l'Asie à la Chambre de commerce des Etats-Unis.

PROPOSITION DE DIRECTIVE SUR LA CONTREFAÇON

Le Parlement européen vient d'adopter en première lecture une proposition de directive pour harmoniser les législations visant au respect des droits de propriété intellectuelle et industrielle. Cette directive, qui prévoit l'indemnisation du défendeur, ne s'appliquera qu'aux "actes commis à l'échelle commerciale", c'est-à-dire "perpétrés en vue d'obtenir un avantage économique et commercial direct ou indirect".